

半導體工程系 進修部四技 111 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級						
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	
校共同必修課程		應修學分數 10 學分	實務應用文	2	2	中文閱讀與表達	2	2																			
			實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2																
											體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2					
通識課程	博雅通識	美感與人文素養	博雅通識/學分數/時數																								
		科技與環境永續	應修學分數 10 學分 (5 大課群 至少任選 3 課群)	博雅通識/學分數/時數																							
		社會與知識經濟		博雅通識/學分數/時數																							
		歷史與多元思維		博雅通識/學分數/時數																							
		全球與未來趨勢		博雅通識/學分數/時數																							
		跨課群認列		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1																							
必修	應修課程數 20 門/ 應修學分數 60 學分	微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	電子學(一)	3	3	電子學(二)	3	3	半導體元件	3	3	微電子專題	3	3	單晶片實驗	3	3					
		電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	微電子電路實驗	3	3	半導體材料概論	3	3	半導體製程	3	3	FPGA/HDL 設計實習	3	3								
		普通物理	3	3	數位邏輯實務	3	3	電腦輔助 電路設計實習	3	3	微電子應用 電路實驗	3	3	半導體量測實驗	3	3											
		計算機概論 (Office 軟體應用)	3	3	計算機與程式應用	3	3																				
系專業課程	應修學分數 至少選修 48 學分	普通物理實驗/3/3						微控制器實務應用/3/3						嵌入式系統實習/3/3						自動控制/3/3							
		電腦網路概論/3/3						電腦數值控制 CAD/CAM 實習/3/3						數位系統應用實務/3/3						感測元件應用電路實習/3/3							
								電腦網路概論/3/3						IC 產業介紹與應用/3/3						感測網路應用實務/3/3							
								半導體封裝工程/3/3						太陽能光電技術/3/3						發光二極體元件及其應用/3/3							
								工程數學/3/3						半導體封裝材料與製程簡介/3/3						半導體封裝元件 EMI/EMC 分析/3/3							
								虛擬圖控儀表實務/3/3						電磁學/3/3						產業經濟學/3/3							
								統計學/3/3						訊號與系統/3/3						產業問題導向學習/3/3							
								真空系統/3/3						物聯網產業介紹與應用/3/3						產業實務見習與鏈結/1/1							
								半導體封裝可靠度分析/3/3						VLSI 設計/3/3						光電元件量測暨封裝實務/3/3							
								數位訊號處理/3/3						虛擬圖控儀表實務/3/3						大數據資料庫應用實務/3/3							
								工業經濟學/3/3						半導體無塵室技術/3/3													

備註：

一、畢業總學分數為 128 學分。

二、專業課程必修 60 學分，專業課程選修 48 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 20 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：承認外系(非通識)選修學分至多 12 學分為專業選修，其中非本院開設之專業選修課程至多承認 6 學分。

